

# 반도체 패키지 재료 및 공정기술

김 구 성 / 전자패키지연구소, 강남대학교

반도체가 5G시대로 접어들면서 이전에는 무시하여도 좋은 항목들이 중요하여 지고 있다. FOWLP는 패키지의 Form Factor를 줄일 수 있는 기술로서 주목받고 있다. 고주파에서의 EMI는 중요한 요소중의 하나이다. 방열 및 발열에 대한 기초이론들이 중요하여지고 있다. 이와 같은 패키지의 기본적인 기능들을 개선하기 위하여 재료업계와 장비업계에서는 고객의 요구의 맞추어 새로운 연구개발이 지속되고 있다.

본 발표는 차세대 반도체가 갖추어야할 물성적 특성을 살펴보고, 연구소에서 중점을 두고 있는 개발 Item과 국내 및 해외의 동향을 발표하려 한다.